

博敏电子股份有限公司

关于签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次签署的《战略合作协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。

●本协议投资金额仅为双方在目前条件下结合市场环境初步预估的金额，实际投资存在不确定性，协议中的投资及产值预估金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺，最终实际投资规模将以正式的投资协议为准。

●由于项目建设周期较长，考虑项目后期市场开拓、产线达产等诸多因素的影响，项目的实际推进及项目建设进度存在不确定性，协议的签署不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续签订具体合作协议、实施情况而定，存在不确定性。

●协议涉及项目投资金额较大，公司投资资金来源为公司自有或自筹资金，虽然公司银行信用良好，但可能存在资金筹措不及时的风险，影响项目进度；同时投资支付可能对公司的现金流造成一定影响，导致财务风险增加。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称“合肥经开区管委会”）于近日签署了《博敏 IC 封装载板产业基地项目战略合作协议》（以下简称“本协议”）。为响应市场需求，双方在相互信任的基础上，致力于建立长期合作伙伴关系，不断拓展合作的广度和深度，打造国际一流的 IC 封装载板产业基地项目，实现互利共赢。

一、本协议签订的基本情况

（一）协议对方的基本情况

对方名称：合肥经济技术开发区管理委员会

法定代表人：秦远望

单位地址：安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路 398 号

单位性质：地方政府机构

与公司的关系：公司与合肥经开区管委会不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

公司与合肥经开区管委会于 2022 年 5 月 25 日在深圳签署了本协议。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为合作框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明确后，根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序

目前协议中所涉及项目尚处于前期论证阶段，尚未取得项目备案、所需建设用地、环评等各项批复文件。

二、框架合作协议的主要内容

甲方：合肥经济技术开发区管理委员会

乙方：博敏电子股份有限公司

（一）合作目标

为加快甲方区域经济发展和社会发展，促进乙方事业拓展，经友好协商，双方就构建长期、稳定的合作关系签署本协议。

（二）协议主要内容

1、乙方计划在合肥经开区投资建设博敏 IC 封装载板产业基地项目，总投资约 60 亿元人民币，占地约 200 亩，项目分两期建设，第一期总投资 30 亿元，第二期总投资 30 亿元，上述投资金额仅为初步预估金额，实际以正式签署的投资协议为准。项目主要从事高端高密度封装载板产品生产，应用领域涵括存储器芯片、微机电系统芯片、高速通信市场及 Mini LED 等。

2、一期计划 2022 年开工建设，二期计划 2025 年开工建设，其中，一期项目全部达产后，预计可实现年销售额 31 亿元，年税收 1.75 亿元，新增就业岗位需求 3,000 人。

3、按照合肥市、经开区现行政策，甲方为本项目在“一事一议”相关政策等方面给予支持。

4、甲方积极协调区内企业与乙方就封装载板采购方面达成战略合作，并且协助本项目扩张合肥市产品市场。

5、甲方积极协调政府基金或政府参股基金参与项目出资，具体由基金公司与乙方另行约定。

6、为尽快落实项目，双方约定按如下时间节点推进：

（1）2022年9月底前，双方签署正式投资协议；

（2）2022年10月底前，项目公司设立；

（3）2022年12月底前，项目一期启动项目拿地手续，待符合建设条件后，即启动开工建设的相关工作。

（三）其他

1、本战略合作协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、项目具体事宜均待双方进一步充分磋商后另行签订正式投资协议。

三、协议签署对公司的影响

（一）本次协议的签署仅为战略合作框架协议，具体合作事宜需双方进一步磋商并以签订的相关项目合同为准。由于项目建设周期较长，同时考虑项目后期市场开拓、产线达产等诸多因素的影响，短期内不会对公司的经营业绩构成实质性影响。

（二）公司具备成熟和先进的HDI生产工艺，在此基础上从2018年开始在管理、人才和技术等方面进行IC载板项目的筹备和投入，目前团队成员囊括国内外IC载板领域的专家，具备丰富的IC载板生产和制造经验，已具备量产能力。本次与开发区管委会建立战略合作关系开展IC封装载板项目，将极大增强公司在集成电路领域高端电子电路产品研发与制造方面的技术水平，同时也会带动公司在原有高多层、HDI等传统电路板制造方面的实力提升，从而实现公司业务领域拓展，增强市场竞争力，助力公司持续高质量的良性发展，符合公司长远发展战略规划。

四、风险提示

（一）本次合作仅为双方前期的合作意向，尚未签署正式投资协议，具体合作事宜及实施进展存在较大不确定性。

（二）本协议投资金额仅为双方在目前条件下结合市场环境初步预估的金额，

实际投资金额存在不确定性，协议中的投资及产值预估金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺，最终实际投资规模将以正式的投资协议为准。

（三）由于项目建设周期较长，考虑项目后期市场开拓、产线达产等诸多因素的影响，项目的实际推进及项目建设进度存在不确定性，协议的签署不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续签订具体合作协议、实施情况而定，存在不确定性。

（四）协议涉及项目投资金额较大，公司投资资金来源为公司自有或自筹资金，虽然公司银行信用良好，但可能存在资金筹措不及时的风险，影响项目进度；同时投资支付可能对公司的现金流造成一定影响，导致财务风险增加。

（五）IC 封装基板属于行业前沿技术，具备较高的技术壁垒和资金壁垒。本协议项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险，具体以公司投资项目公告为准。

（六）公司将按照《公司章程》及相应法律法规的规定和要求，推动本协议涉及的各项后续事宜，并及时履行相应的决策审批程序和相关的信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日